

# 반도체

## Computex 2026 키노트 리뷰

- 에이전트 AI 확산으로 오케스트레이션 역량의 중요성 확대
- CPU 역할의 재부각
- 엣지 디바이스의 역할 확대

### Computex 2026 주요 참석 업체 키노트 의제와 함의

Computex 2026이 개최되며 6월 1~2일 양일간 엔비디아, 퀄컴, 마벨, 인텔의 키노트가 진행되었다. 키노트를 관통한 주제는 **에이전트 AI**였다. 각 기업은 에이전트 AI 도입에 따른 변화와 이에 대응하는 전략을 주요 의제로 제시했으며, 주요하게 부각된 의제는 오케스트레이션 역량의 중요성 확대, CPU 역할의 재부각, 그리고 엣지 디바이스의 역할 확대였다.

#### [1] 오케스트레이션 역량의 중요성 확대

에이전트 AI 확산으로 복수의 LLM, 메모리, 외부 도구를 유기적으로 연결하는 오케스트레이션 역량의 중요성이 확대되고 있다. 엔비디아는 **LLM과 하네스가 결합된 에이전트 구조**를 제시하며 시스템 단위 오케스트레이션의 중요성을 강조했다며, 마벨은 데이터 이동량 증가에 따른 연결성(Connectivity)을 차세대 AI 병목으로 제시했다.

#### [2] CPU 역할의 재부각

오케스트레이션 중요성 확대는 CPU 역할의 재부각으로 이어진다. 엔비디아는 **지연시간 최소화**를 에이전트 CPU의 핵심 경쟁력으로 제시했으며, Vera CPU가 x86 대비 1.8배 높은 에이전트 샌드박스 성능을 제공한다고 강조했다. 인텔은 Xeon 6+를 공개하며, 랙스케일 기준 32U당 36,000개 이상의 코어와 최대 150,000개 에이전트 실행 능력을 제시했다.

#### [3] 엣지 디바이스의 역할 확대

에이전트 AI의 실행 기반은 엣지 디바이스로 확장되고 있다. 엔비디아는 **Windows 기반 AI PC와 RTX Spark 슈퍼칩 N1X**를 공개했으며, 1PFLOPs(FP4) 성능의 Blackwell RTX GPU와 20코어 Grace CPU를 결합해 에이전트 실행 역량을 강조했다. 퀄컴은 작업 실행과 데이터 수집을 담당하는 엔드포인트로서 디바이스 역할이 재편되고 있음을 제시했다.

### 메모리 업종 투자의견 매수 제시

CPU 중요성 증대와 AI 실행 기반의 엣지 확장은 메모리 업종에 우호적인 구조적 변화다. 엔비디아 Vera CPU는 LPDDR5X 기반 1.2TB/s 대역폭(전작 대비 +130%)을 구현했으며 차세대 Rosa(예상)에서는 LPDDR6를 탑재할 가능성이 높아지고 있다. AI PC 역시 128GB LPDDR5X 통합 메모리를 탑재하며 엣지 디바이스의 메모리 수요 확대를 시사한다.

메모리 업종에 대한 비중확대 관점과, 삼성전자(목표가 55 만원), SK 하이닉스(목표가 380 만원)에 대한 매수 의견을 유지한다.

### Nvidia GTC Taipei 2026

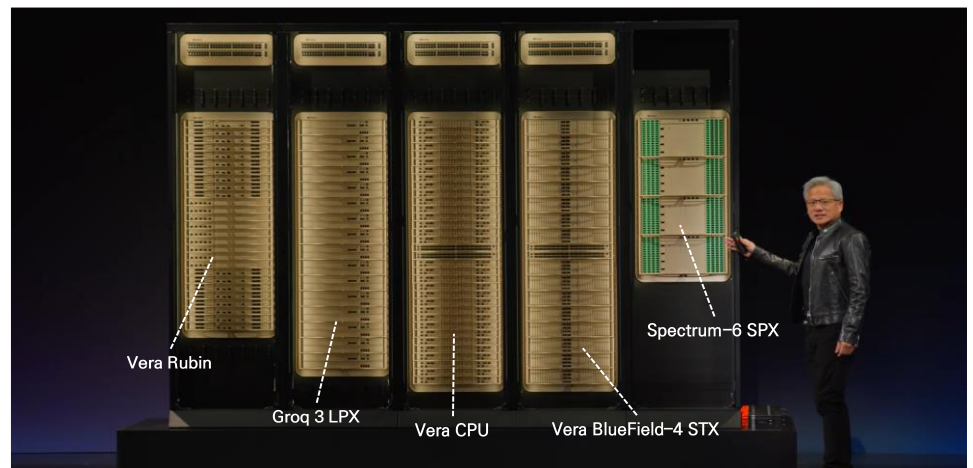
엔비디아 GTC Taipei 2026의 핵심은 **에이전트 컴퓨팅 시대의 본격화**였다. 엔비디아는 LLM과 이를 오케스트레이션하는 하네스가 결합된 에이전트 구조를 제시하며, AI 컴퓨팅의 경쟁력이 시스템 단위 오케스트레이션 역량으로 확장되고 있음을 강조했다.

이러한 구도 속에서 엔비디아는 **1) Vera Rubin의 완전 생산 진입, 2) 에이전트 워크로드에 최적화된 Vera CPU, 3) 로컬 에이전트를 겨냥한 AI PC를** 공개하며, 데이터센터부터 PC까지 이어지는 에이전트 컴퓨팅 전략을 제시했다.

#### 1) Vera Rubin의 완전 생산 진입

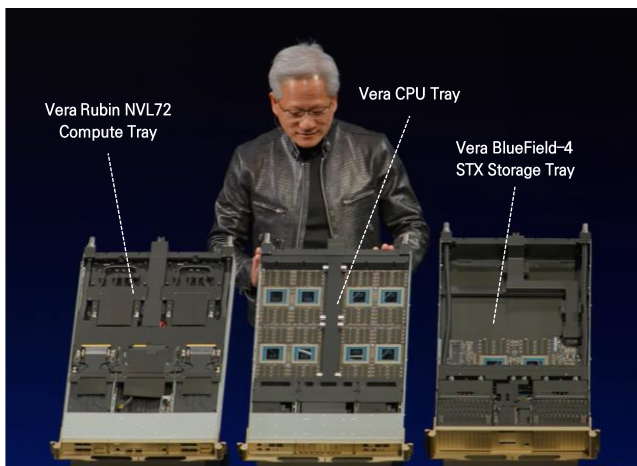
엔비디아는 **Vera Rubin이 완전 생산 단계(Full Production)에 진입했음을 공식화**했다. Vera Rubin 공급량은 Grace Blackwell 대비 2배 규모로 확대됐으며, 랙 조립 시간은 기존 Grace Blackwell의 2시간에서 5분으로 단축됐다. 또한 DSX 플랫폼을 발표 전면에 내세우며, 단순 하드웨어 공급을 넘어 AI 인프라 구축 역량까지 확보하고 있음을 강조했다. 이는 Vera Rubin의 대규모 상용 배치 가시성을 높이는 요인이다.

그림 1. Vera Rubin 랙 스케일 시스템 구성



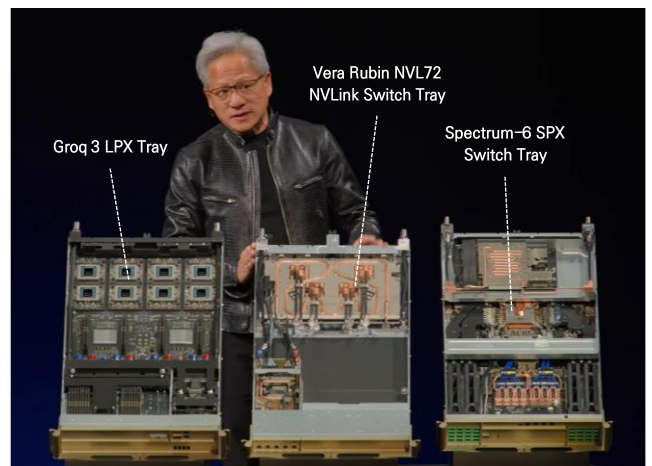
자료: 엔비디아, 미래에셋증권 리서치센터

그림 2. Vera Rubin 시스템 트레이 구성 (1)



자료: 엔비디아, 미래에셋증권 리서치센터

그림 3. Vera Rubin 시스템 트레이 구성 (2)



자료: 엔비디아, 미래에셋증권 리서치센터

## 2) 에이전트 워크로드에 최적화된 Vera CPU

CPU 사용의 주체가 인간에서 에이전트로 이동하며 요구 성능도 변화하고 있다. 기존 컴퓨팅 환경에서는 코어를 가상화해 다수 사용자에게 할당하고, 전체 처리량(throughput)을 극대화하는 것이 중요했다. 반면 **AI 환경에서는 지연시간(latency)이 핵심**이다. CPU 처리 지연이 전체 시스템의 대기 시간으로 이어지고, 이는 토큰 생산량 감소로 연결되기 때문이다.

Vera는 이러한 에이전트 워크로드에 최적화된 CPU이다. 엔비디아가 자체 설계한 Olympus 코어를 적용했으며, 88코어/176스레드 구성으로 SMT(Spatial Multithreading) 구조를 채택하고 있다. 엔비디아에 따르면 **Vera CPU의 에이전틱 샌드박스 성능은 x86 CPU(최고 성능 기준) 대비 1.8배 높으며, 코어당 메모리 대역폭은 3배 수준에 달한다.**

이러한 성능 우위는 Vera CPU의 지연시간 최소화 설계에서 비롯된다. 설계 방향의 핵심은 1) 단일 스레드 성능 강화와 2) 대역폭 확대다.

**1) 단일 스레드 성능 강화:** 높은 IPC 확보를 위해 Olympus 코어에 10-wide decode 엔진을 적용했다. 이를 통해 한 클럭 사이클에 더 많은 명령어를 코어에 공급하고 해석한다. 또한 실행 순서 최적화(out-of-order engine), 분기 예측(neural branch predictor), 데이터 선반입(prefetcher) 등 설계를 통해 명령어 대기과 데이터 공급 지연을 줄였다.

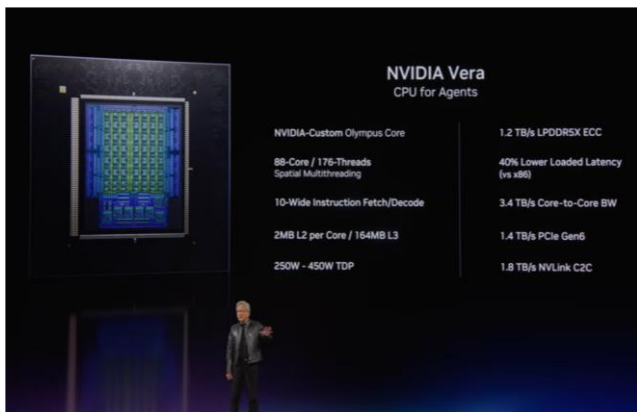
**2) 대역폭 확대:** 메모리 측면에서는 LPDDR5X 기반 1.2TB/s 대역폭을 구현해 x86 대비 피크 메모리 접근 지연시간을 40% 낮췄다. CPU 내부에서는 전체 코어를 모놀리식 메시 구조로 연결해 3.4TB/s의 코어 간 대역폭을 확보했다. 외부 연결 측면에서도 1.4TB/s PCIe Gen6와 1.8TB/s NVLink-C2C를 적용해 데이터 이동 지연을 최소화했다.

표 1. Vera CPU 주요 스펙 및 비교

구분	Grace CPU	Vera CPU	전작 대비 개선
코어	Arm Neoverse V2	Olympus	-
코어수	72개	88개	+22%
메모리	LPDDR5X	SOCAMM (LPDDR5X)	-
메모리 대역폭	최대 512GB/s	1.2TB/s	+130%
NVLink C2C 대역폭	900GB/s	1.8TB/s	+100%
PCIe 링크	PCIe Gen5	PCIe Gen6	-

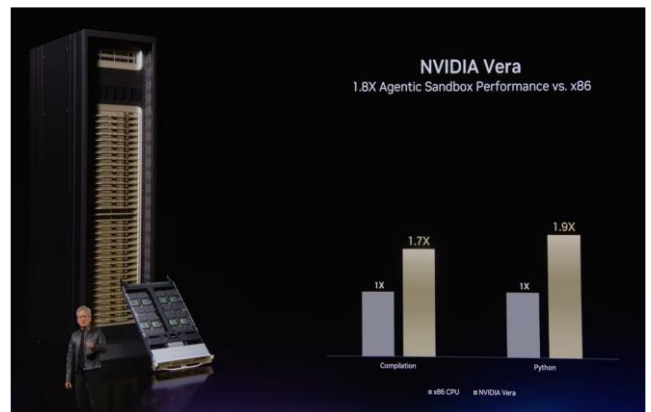
자료: 엔비디아, 미래에셋증권 리서치센터

그림 4. Vera CPU 주요 스펙 발표



자료: 엔비디아, 미래에셋증권 리서치센터

그림 5. Vera CPU 및 x86 기반 CPU 성능 비교



자료: 엔비디아, 미래에셋증권 리서치센터

### 3) 로컬 에이전트를 겨냥한 AI PC

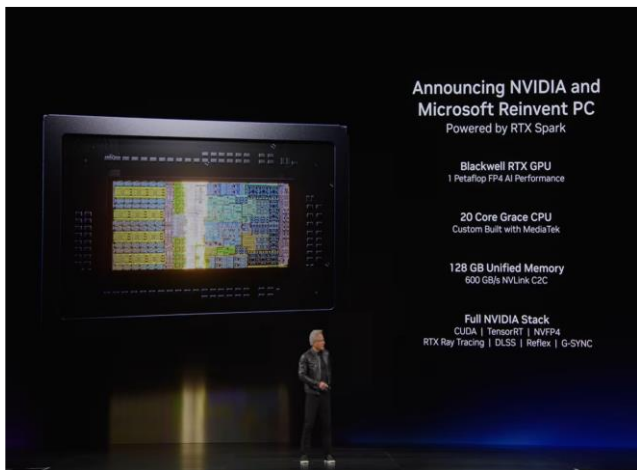
엔비디아는 이번 키노트에서 AI PC를 통해 PC의 역할 변화를 제시했다. 기존 PC가 사용자가 애플리케이션을 직접 조작하는 기기였다면, AI PC는 에이전트가 사용자의 의도를 이해하고 파일/애플리케이션/모델을 연결해 작업을 수행하는 개인 AI 플랫폼이다. 이를 구현하기 위해 엔비디아는 Microsoft와 함께 Windows 기반 AI PC를 제시했다.

엔비디아 AI PC에는 RTX Spark 슈퍼칩이 탑재된다. 금번 공개된 N1X는 TSMC 3nm 기반 칩으로, 700억 개의 트랜지스터를 집적했다. 6,144개 CUDA 코어를 갖춘 Blackwell RTX GPU는 FP4 기준 1PFLOPs의 성능을 제공하며, 20코어 Grace CPU와 NVLink-C2C로 연결된다. 또한 128GB LPDDR5X 통합 메모리를 공유해 칩 간 데이터 이동 병목을 줄였고, CUDA/TensorRT 등 엔비디아 소프트웨어 스택과의 호환성을 제공한다.

엔비디아 RTX Spark 기반 AI PC는 노트북과 데스크톱 두 가지 형태로 제공될 예정이다. 엔비디아는 ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI 등 주요 PC OEM과의 협력을 밝혔으며, 향후 아키텍처 세대마다 신규 제품을 출시하겠다는 로드맵도 제시했다.

그림 6. RTX Spark N1X 주요 스펙 발표

그림 7. RTX Spark 노트북 및 협력사 발표



자료: 엔비디아, 미래에셋증권 리서치센터

자료: 엔비디아, 미래에셋증권 리서치센터

그림 8. 엔비디아 아키텍처 및 AI PC 로드맵



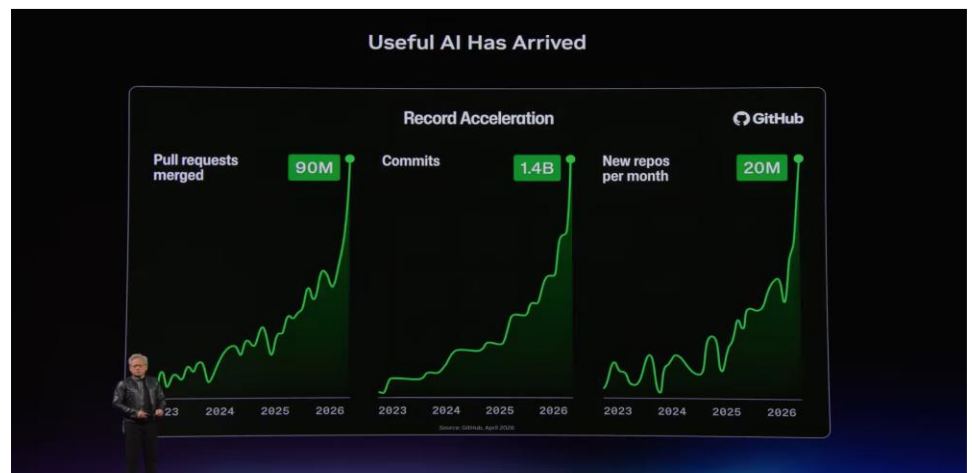
자료: 엔비디아, 미래에셋증권 리서치센터

### Appendix

#### AI 생산성 확장의 본격화

키노트의 첫 번째 메시지는 AI가 이미 실질적인 생산성 향상으로 연결되고 있다는 점이었다. 젠슨 황은 GitHub 커밋 데이터를 대표 사례로 제시했다. 커밋은 GitHub 이용자가 커뮤니티 내 소프트웨어를 다운로드/수정한 뒤 다시 업로드하는 작업을 의미한다. GitHub 커밋 건수는 23년 3억 건, 24년 4억 건, 25년 5억 건으로 선형적 흐름을 보이다, 26년 초에는 YoY 3배 성장한 것으로 나타났다. 이는 소프트웨어 개발 인력 규모가 크게 변하지 않은 상황에서도 산출량이 3배 확대되었음을 의미한다. AI 생산성 확장의 본격화이다.

그림 9. GitHub 커밋 수 추이

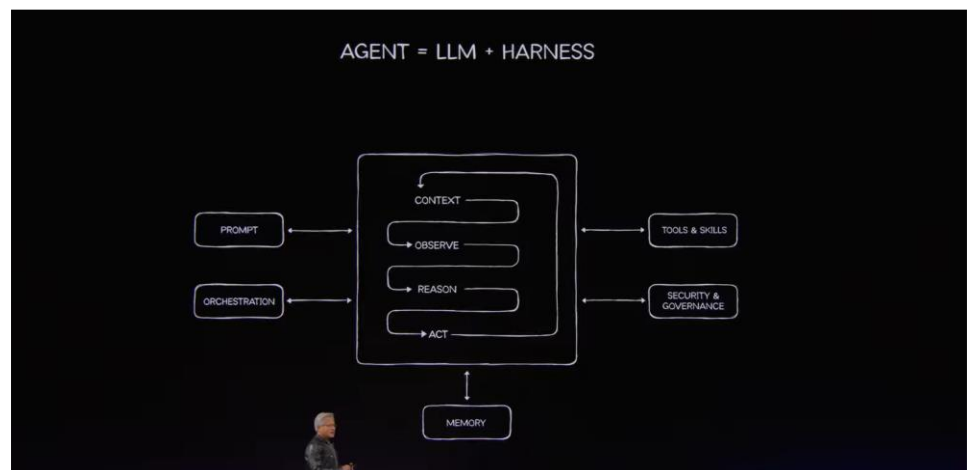


자료: 엔비디아, 미래에셋증권 리서치센터

#### 에이전트 컴퓨팅 패턴

생산성 확장의 배경에는 에이전트 컴퓨팅 패턴이 자리한다. 젠슨 황은 에이전트를 애플리케이션, LLM을 연산을 담당하는 코드, 하네스를 이를 오케스트레이션하는 운영체제로 비유했다. 이러한 구조 하에 AI 컴퓨팅의 경쟁력은 단순 연산 성능을 넘어 LLM, 메모리, 외부 도구를 유기적으로 연결하는 시스템 오케스트레이션 역량에서 비롯된다.

그림 10. LLM과 하네스가 결합한 에이전트 컴퓨팅 구조



자료: 엔비디아, 미래에셋증권 리서치센터

### Qualcomm Keynote

퀄컴은 Computex 2026 키노트에서 에이전틱 AI 도입에 따른 두 가지 방향성을 제시했다. **1) 디바이스 역할의 재편과 2) 분산 컴퓨팅의 필요성**이다. 기존 디바이스가 사용자가 직접 조작하는 인터페이스 중심의 기기였다면, **에이전틱 AI 시대의 디바이스는 사용자의 조작을 지원하는 동시에 에이전트가 작업을 실행하고 데이터를 수집하는 엔드포인트로 기능한다.**

이러한 **엣지 디바이스 변화 속에서 경쟁력은 전력 효율과 지연시간으로 이동**한다. 개인용 디바이스는 제한된 에너지 환경에서도 상시 구동되어야 하며, 피지컬 AI 영역에서는 정확도와 저지연이 동시에 요구된다. 퀄컴은 그동안 모바일과 엣지 디바이스에서 제한된 자원으로 컴퓨팅 성능을 극대화해온 경험을 핵심 경쟁력으로 강조했다.

에이전트 AI 확산은 토큰 수요의 구조적 폭증으로 이어진다. 퀄컴은 단일 턴 대화형 AI의 토큰 소비가 작업당 약 1만 토큰 수준인 반면, 자율적 단단계 작업을 수행하는 에이전트 AI는 약 100만 토큰까지 증가한다고 설명했다. 퀄컴이 제시한 **30년 글로벌 토큰 수요는 10초당 1.27T 토큰 수준으로, 이는 26년 3.17B 토큰 대비 약 40배 증가한 수준**이다.

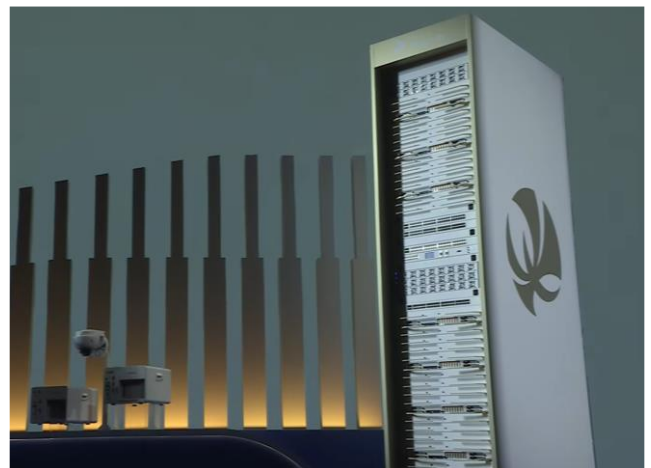
이러한 토큰 수요에 대응하기 위해서는 **분산 컴퓨팅이 중요**해진다. 이는 **클라우드와 엣지 전반의 컴퓨트 연속체에서 워크로드를 동적으로 배분하는 구조**이다. 퀄컴은 분산 컴퓨팅을 적용한 Claude Code 기반 코딩 세션은 비용을 60% 절감했으며, Snapdragon 웹페이지 생성 작업에서는 토큰을 30% 줄이고 비용을 4배 낮췄다고 설명했다.

또한 이러한 분산형 에이전트 AI를 구현하려면 차세대 무선 인프라가 필요하며, 퀄컴은 6G를 AI 시대를 위해 설계된 첫 번째 무선 세대로 정의했다. 6G의 핵심은 단순한 고속 연결이 아니라, **연결성, 분산 컴퓨팅, 센싱을 결합해 네트워크를 AI 연산과 물리적 환경 인식까지 수행하는 AI 네이티브 인프라로 확장**하는 데 있다.

마지막으로 퀄컴은 **데이터센터 제품 브랜드 Dragonfly**를 공개하며, 엣지에서 데이터센터까지 이어지는 컴퓨트 연속체 전반을 포괄하겠다는 전략을 제시했다. 구체적인 스펙 등 세부 내용 공개는 제한적이었으나, 데이터센터 시장 진출을 공식화했다는 점에서 의미가 있다.

그림 11. 에이전트 AI를 전면에 내세운 Qualcomm 키노트

그림 12. Qualcomm Dragonfly 제품 발표



자료: 퀄컴, 미래에셋증권 리서치센터

자료: 퀄컴, 미래에셋증권 리서치센터

### Marvell Keynote

마벨은 Computex 2026 키노트에서 AI 시스템의 병목이 연결성(Connectivity)으로 이동하고 있음을 강조했다. 에이전트, 추론 모델, MoE 확산으로 데이터 이동량이 증가하며, AI 인프라는 더 높은 대역폭과 낮은 지연시간을 요구하고 있다. 또한 워크로드가 단일 데이터 센터를 넘어 확장되며, 데이터센터 간 연결성(Scale-across)도 인프라의 핵심이 되고 있다.

OFC 2026 참가가: NEXT AI 병목은 나야, OPTICS(박준서) [보고서 링크](#)

시스템 내 대역폭 요구 증가는 광 도입 범위를 확대시키고 있다. 구리는 비용 측면에서 강점이 있으나, 대역폭이 높아질수록 전송 가능 거리가 짧아지는 한계를 갖는다. 이에 따라 기존 구리가 주로 사용되던 랙 내부에서도 구리의 한계가 부각되고 있으며, 400G/lane 전환 이후에는 랙 전체를 구리로 연결하기 어려워 광 도입이 불가피해질 전망이다.

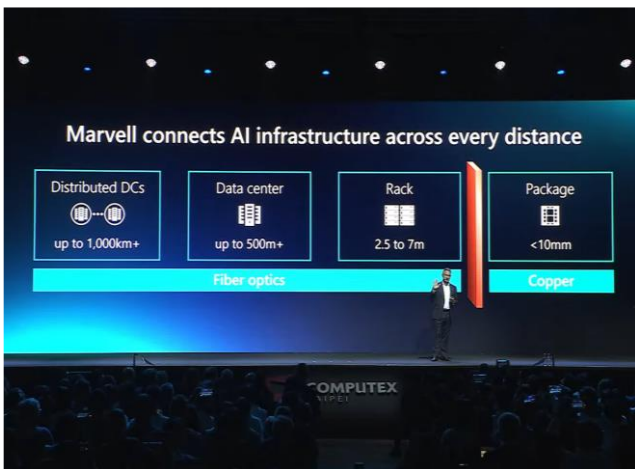
마벨은 금번 키노트에서 AI 인프라의 연결성 요구에 대응하는 신제품과 기술 포트폴리오를 공개했다. 특히 전송 거리에 따라 요구되는 네트워크 솔루션이 달라진다는 점을 강조하며, 데이터센터 간 장거리 광 연결부터 데이터센터 내부 스위칭, 랙 내부 SerDes, 패키지 내부 다이 투 다이까지 포괄하는 전 거리 연결성 포트폴리오를 경쟁력으로 제시했다.

랙 내부 Scale-up에서는 51.2T CPO 기반 스위치를 선보였다. 기존 전면 패널 광 모듈 방식과 달리, 16개의 3.2T 광 엔진을 스위치 실리콘 주변에 배치해 PCB 구리 트레이스를 거치지 않고 패키지에서 직접 광 신호를 전송하는 구조다. 해당 제품은 광 연결이 랙 내부로 확장되는 흐름이 실제 제품으로 구체화되고 있음을 보여준다.

데이터센터 간 Scale-across에서는 업계 최초 1.6T coherent 광 솔루션인 COLORZ 1600을 공개했으며, 2nm 공정 기반으로 올해 말 샘플링에 돌입할 예정이다. 데이터센터 내부 Scale-out에서는 3nm 기반 1.6T PAM4 솔루션인 Ara Family 1.6T DSP를 작년부 터 램프업 중이며, 이더넷 스위칭에서는 100T 이더넷 스위치 Teralynx T100을 발표했다.

그림 13. Copper Wall로 랙 내부까지 확대되는 광 연결

그림 14. Marvell 51.2T CPO 기반 Switch 발표



자료: 마벨, 미래에셋증권 리서치센터

자료: 마벨, 미래에셋증권 리서치센터

그림 15. Marvell COLORZ 1600 발표



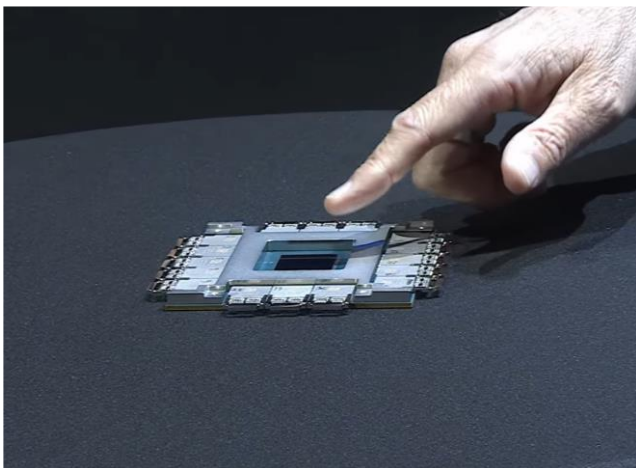
자료: 마벨, 미래에셋증권 리서치센터

그림 16. Marvell Ara Family 1.6T DSP & Teralynx T100 이더넷 스위치 발표



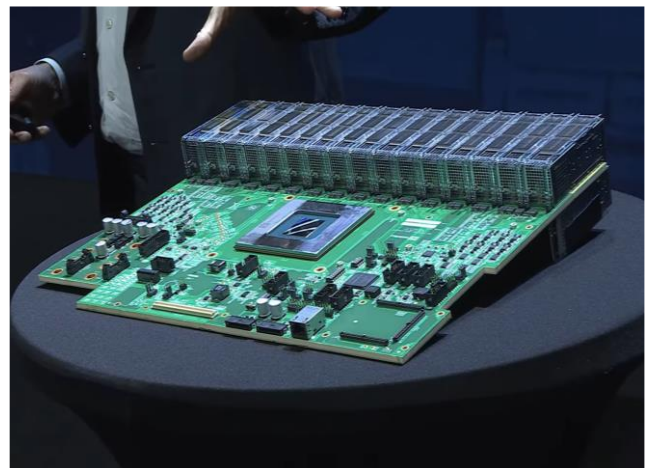
자료: 마벨, 미래에셋증권 리서치센터

그림 17. Marvell 51.2T CPO 기반 Switch



자료: 마벨, 미래에셋증권 리서치센터

그림 18. Marvell Teralynx T100 이더넷 스위치



자료: 마벨, 미래에셋증권 리서치센터

## Intel Keynote

인텔 Computex 키노트의 핵심은 1) 18A 공정의 제품화 진전과 2) 에이전틱 AI 시대 x86 CPU 역할의 재부각이었다. 인텔은 18A 기반 신규 프로세서 라인업을 통해 공정 로드맵이 제품 확장 단계에 진입했음을 강조했다. 동시에 에이전트 AI 확산으로 CPU의 오케스트레이션 역할이 확대됨을 제시하고, 이에 대응한 신제품과 파트너십을 공개했다.

인텔은 18A 공정이 Full scale 단계에 진입했음을 강조했다. 첫 18A 기반 제품인 Core Ultra Series 3는 300개 이상, 4월 공개된 Core Series 3도 70개 이상 PC 디자인으로 확대되었다. 또한 Core Ultra Series 3에서 파생된 게이밍용 Arc G3를 공개했으며, 경쟁 제품 대비 40% 이상 빠르고 동일 성능 기준 전력 소모는 절반 수준이라고 설명했다.

인텔은 IDC를 인용해 30년까지 설치 서버의 80%가 x86 기반일 것으로 전망했다. 기존 x86의 주력 영역인 범용 데이터센터 워크로드는 30년까지 80GW에서 100GW 규모로 확대될 것으로 예상했다. 동시에 에이전틱 AI 확산으로 데이터센터가 기존 범용 워크로드와 AI 워크플로를 함께 처리하게 되면서, x86 CPU의 역할이 확대될 수 있음을 강조했다.

이러한 수요에 대응해 인텔은 18A 기반 Xeon 6+를 공개했다. 해당 제품은 288개 E-코어와 576MB L3 캐시를 탑재했으며, 기존 P-코어 기반 Xeon 6와 함께 데이터센터 라인업을 구성한다. 랙스케일 기준 32U당 36,000개 이상의 코어를 제공하며, 해당 구성이 최대 150,000개의 에이전트를 실행할 수 있다고 설명했다.

인텔은 SambaNova와의 다년간 협력을 통해 올해 초 발표한 SN-50도 선보였다. SN-50은 Xeon 6 프로세서와 SambaNova SN-50 RDU를 결합한 에이전트 워크로드용 랙스케일 인프라로, 올해 말 고객 출하가 예정되어 있다. CPU, RDU, GPU가 결합한 이기종 분리형 추론 구조를 시연했으며, GPU 단독 추론 대비 2~3배 빠른 성능을 확인했다고 설명했다.

마지막으로 인텔은 ASIC(Purpose-built silicon) 영역의 파트너십 확대도 강조했다. 구글에 IPU(Infrastructure Processing Unit)를 제공하는 파트너십을 시작했으며, 에릭슨과는 글로벌 무선 인프라용 실리콘 협력을 진행 중이라고 밝혔다. 이는 인텔의 사업 기회가 범용 CPU를 넘어 고객 맞춤형 실리콘 영역으로 확장되고 있음을 보여준다.

그림 19. Intel Core Ultra Series 3: 300개 이상 디자인 출하



자료: 인텔, 미래에셋증권 리서치센터

그림 20. Intel Xeon 6+ 발표



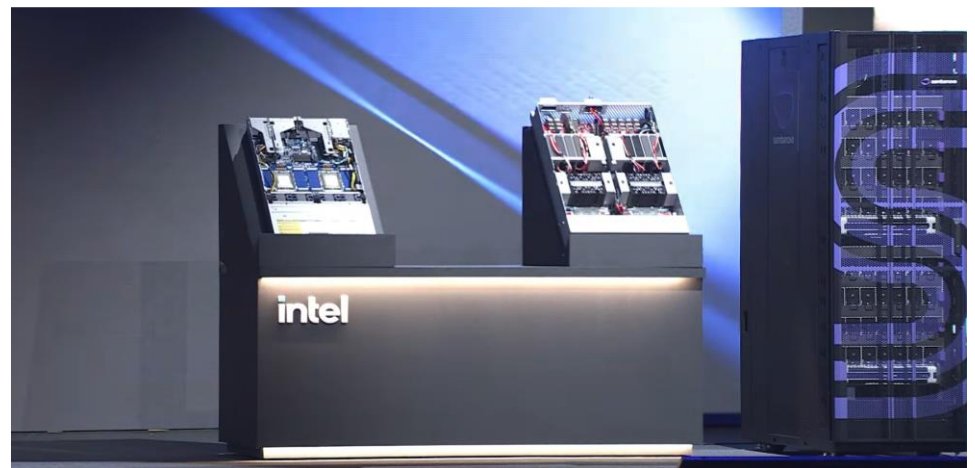
자료: 인텔, 미래에셋증권 리서치센터, STH

그림 21. Intel Arc G3 게이밍 프로세서 발표



자료: 인텔, 미래에셋증권 리서치센터

그림 22. SN-50 에이전트 워크로드용 렉스케일 AI 인프라



자료: 인텔, 미래에셋증권 리서치센터

그림 23. Google/Ericsson과의 Purpose-built silicon 파트너십 발표



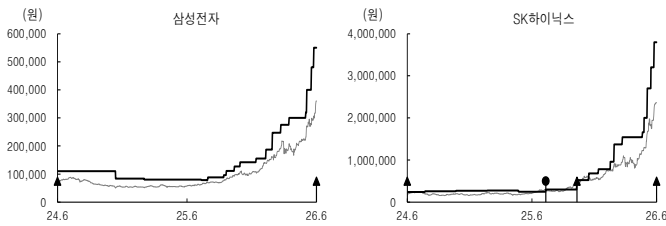
자료: 인텔, 미래에셋증권 리서치센터

투자의견 및 목표주가 변동추이

제시일자	투자의견	목표주가(원)	과리율(%)		제시일자	투자의견	목표주가(원)	과리율(%)	
			평균주가대비	최고(최저)주가대비				평균주가대비	최고(최저)주가대비
삼성전자 (005930)					2026.05.27	매수	3,800,000	-	-
2026.05.27	매수	550,000	-	-	2026.05.18	매수	3,200,000	-41.11	-35.88
2026.05.20	매수	480,000	-38.13	-37.60	2026.05.07	매수	2,700,000	-31.07	-26.81
2026.05.07	매수	400,000	-30.00	-26.00	2026.04.28	매수	2,000,000	-29.66	-19.95
2026.05.04	매수	320,000	-16.88	-16.88	2026.04.23	매수	1,660,000	-24.28	-22.17
2026.03.18	매수	300,000	-32.55	-24.67	2026.02.23	매수	1,540,000	-35.84	-20.52
2026.02.23	매수	275,000	-29.93	-20.73	2026.01.30	매수	1,370,000	-35.82	-30.73
2026.01.30	매수	247,000	-31.01	-23.04	2026.01.19	매수	956,000	-18.37	-9.94
2026.01.12	매수	187,000	-19.63	-13.16	2025.12.15	매수	782,000	-15.38	-3.32
2025.12.15	매수	155,000	-21.84	-9.03	2025.11.17	매수	680,000	-19.03	-13.68
2025.10.31	매수	142,000	-27.74	-21.76	2025.10.29	매수	520,000	13.77	19.23
2025.10.15	매수	127,000	-21.89	-18.03	2025.10.29	매수	520,000	0.19	0.19
2025.09.22	매수	111,000	-21.22	-14.95	2025.10.13	매수	520,000	-8.35	2.88
2025.09.15	매수	96,000	-17.24	-16.15	2025.07.14	중립	300,000	-2.47	42.67
2025.08.01	매수	88,000	-19.69	-14.32	2025.04.25	매수	244,000	-4.68	21.72
2025.07.14	매수	78,000	-13.28	-6.92	2025.01.24	매수	277,000	-29.61	-21.12
2025.02.03	매수	80,000	-28.59	-20.25	2024.10.24	매수	270,000	-31.75	-16.48
2024.11.14	매수	84,000	-35.00	-30.60	2024.07.25	매수	260,000	-31.80	-23.19
2024.05.16	매수	110,000	-34.12	-20.18	2024.05.16	매수	240,000	-9.50	0.42

SK하이닉스 (000660)

\* 과리율 산정: 수정주가 적용, 목표주가 대상시점은 1년이며 목표주가를 변경하는 경우 해당 조사분석자료의 공표일 전일까지 기간을 대상으로 함



투자의견 분류 및 적용기준

기업	산업
매수 : 향후 12개월 기준 절대수익률 20% 이상의 초과수익 예상	비중확대 : 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 대비 높거나 상승
Trading Buy : 향후 12개월 기준 절대수익률 10% 이상의 초과수익 예상	중립 : 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 수준
중립 : 향후 12개월 기준 절대수익률 -10~10% 이내의 등락이 예상	비중축소 : 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 대비 낮거나 약화
매도 : 향후 12개월 기준 절대수익률 -10% 이상의 추가하락이 예상	

매수(▲), Trading Buy(■), 중립(●), 매도(◆), 추가(←), 목표주가(→), Not covered(■)

투자의견 비율

매수(매수)	Trading Buy(매수)	중립(중립)	매도
80.84%	0%	18.56%	0.6%

\* 2026년 03월 31일 기준으로 최근 1년간 금융투자상품에 대하여 공표한 최근일 투자등급의 비율

Compliance Notice

- 당사는 자료 작성일 현재 SK하이닉스, 삼성전자 을(를) 기초자산으로 하는 주식워런트증권에 대해 유동성공급자(LP)업무를 수행하고 있습니다.
- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.